

Крупнейшие производители памяти, включая Samsung, Micron и SK hynix, усилили конкуренцию за лидерство на рынке HBM3E — нового поколения высокоскоростной памяти, которая востребована для работы с искусственным интеллектом (ИИ). На фоне торговых напряженности и нестабильности поставок компании стремятся ускорить производство, чтобы занять выгодные позиции перед возможными новыми пошлинами со стороны США.

По информации корейских СМИ, Samsung готовится начать массовое производство HBM3E уже в следующем месяце. Однако компания все еще ожидает подтверждения от NVIDIA, которая должна одобрить качество их решений. Несмотря на отставание от конкурентов в технологиях HBM, Samsung надеется на сделку с NVIDIA, чтобы сократить этот разрыв.

В это же время Micron, по данным издания Sisa Journal, уже запустила массовое производство 12-слойной версии HBM3E и планирует использовать ее в новых серверных системах NVIDIA под названием Blackwell Ultra B300. Сообщается, что производственные линии Micron загружены на полную мощность, а сама компания активно наращивает объемы, претендуя на долю рынка, которую сейчас удерживает SK hynix.

На фоне растущего интереса к новым решениям в сфере ИИ и увеличения спроса на энергоэффективную и быструю память, гонка за HBM3E усиливается. Компании уже смотрят в будущее — на HBM4 — и стремятся укрепить свои позиции как можно раньше. В условиях неопределенности NVIDIA также заинтересована в диверсификации поставщиков и снижении зависимости от одного производителя.